

## 深圳市景旺电子股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

(记录表编号：2025-0201)

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2025年2月5日-2月28日
地点/方式	券商策略会、现场调研
参与单位或人员（排名不分先后）	长江证券、海通证券、天风证券、国海证券、开源证券、华福证券、广发证券、财通证券、国投证券、高盛证券、兴业证券、东方证券、国信证券、东方财富证券、西南证券、中泰证券、中信建投证券、浙商证券；景顺长城基金、工银瑞信基金、天弘基金、华夏基金、嘉实基金、国寿养老、易方达基金、国联安基金、中欧基金、招商基金、长信基金、兴银基金、泰康基金、百年资管、民生加银基金、招商信诺、银华基金、新华资产、Point72、3W基金、人保养老、聚鸣投资、财通基金、平安基金、富国基金、太平资产、华商基金、交银施罗德基金、大成基金、汇丰晋信基金、华泰保兴基金、兴全基金、太平基金、龙石资本、Pinpoint、Grand Alliance Asset Management、Templeton、Millennium、博时基金、长城基金、长盛基金、诺安基金、鹏华基金、源峰基金、中信保诚基金、中邮创业基金、浦银理财、盈峰资本。
上市公司接待人员	董事会秘书：黄恬先生 证券事务代表：蒋靖怡女士
活动主要内容	问：如何研判公司2025年汽车电子业务的景气度？ 答：公司已深耕汽车PCB领域多年，近年来抢抓汽车电动化、智能化、网联化发展的市场机遇，汽车电子业务高速增长，2023年已跻身全球汽车PCB供应商前列。凭借坚实的品质保证、强大的研发实力和良好的品牌形象，公

司多年来与全球头部 Tier 1 厂商（如博世、大陆、佛瑞亚、法雷奥、安波福、Denso 等）以及国内领先的新能源厂商（如比亚迪、理想、零跑等）建立稳定的长期合作关系。公司具备提供全产品解决方案的能力，产品覆盖各类汽车零部件，近年来智能驾驶、智能座舱相关应用的产品收入占比快速提升。随着智能驾驶在更广泛车型的渗透率进一步提升以及可预见的 L3 级别智能驾驶商业化的加速落地，HDI、高多层、软板、软硬结合板等高端产品在车端应用愈加广泛，将为公司汽车电子业务收入及盈利能力带来正向影响。公司对汽车电子业务的发展充满信心，将进一步加大全球市场开拓力度，提升服务质量，拓宽、加深与头部客户的合作，巩固并提升公司在全球汽车 PCB 供应商中的市场地位。

**问：在“智驾平权”的大趋势下，公司智能驾驶的业务布局如何？**

答：智驾技术正在经历技术迭代与产业升级的双重驱动，汽车行业领先厂商对智能驾驶应用推动积极，将带动上游硬件产品的规格升级和需求量增长，对于 PCB 而言，智能驾驶使单车传感器数量增加、自动驾驶域与智能座舱域在跨域融合中央控制的趋势下逐步走向融合，推动 PCB 在用量、层数、材料、加工技术等方面均有升级。公司在 ADAS 和智能座舱等领域已有布局，产品已被应用于毫米波雷达、摄像头、激光雷达、HUD、信息娱乐系统、照明系统、ADCU、新能源充配电、电驱、V2X、通信模组、高级驾驶辅助域控系统、动力电池、OBC 等多个模块，近年来相关应用领域订单增速较高。

**问：激光雷达和毫米波雷达被众多车企视为高阶智能驾驶的关键传感器，且可用于人形机器人领域，公司是否有相关产品？**

答：在智能驾驶应用场景中，城市场景占据用户较高的驾驶时长比例，且较高速场景的环境复杂程度有 10-100 倍提升。目前头部车企已基本达成共识，高阶智驾的城市 NOA 方案需实现去高清地图、加强感知层输入，为车企端到端数据的训练提供更多支持。激光雷达具备以下几点优势：分辨率高，与视觉方案相比不受光线影响；与毫米波雷达相比，对不规则三维物体的识别精度更高。同时随着近年激光雷达成本优势的凸显，在车端的前装率有较大提升。机器人有望广泛应用于家庭服务和工业场景中，激光雷达有助于增

	<p>强机器人的自主导航能力和环境识别能力，使得机器人能够在复杂环境下更安全、精确地执行任务。公司已向激光雷达头部供应商长期稳定供应 PCB 产品，未来公司将围绕客户的需求进行相关产品的进一步开发和部署，积极争取相关项目机会，推动订单放量和市场份额的持续提升。</p> <p><b>问：公司如何看待 AI 眼镜未来发展趋势，是否有相关产品应用？</b></p> <p>答：AI 眼镜属于端侧 AI 增长较快且极富潜力的品类，公司下游多个客户均有布局。AI 眼镜对 PCB 的轻量化、小型化、可弯折、散热性能均有更高的要求。公司产品中的高阶 HDI/Anylayer、软硬结合板、软板、类载板等产品可应用于 AI 眼镜，公司也积极配合客户开发相关产品，持续提升公司在 AI 端侧市场的竞争力。</p> <p><b>问：公司本次不提前赎回“景 23 转债”是出于何种考虑？</b></p> <p>答：鉴于“景 23 转债”发行上市时间较短，距离 6 年存续届满尚远，综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会 2 月 19 日讨论决定本次不行使“景 23 转债”的提前赎回权利，且若在 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日（即未来 6 个月）再次触发“景 23 转债”有条件赎回条款，公司亦不行使“景 23 转债”的提前赎回权。</p> <p><b>问：公司 2025 年是否有再融资计划？</b></p> <p>答：公司目前现金流情况良好，银行授信额度充足，如有相关事项，公司将按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。</p> <p>注：调研过程中，公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件	无
记录时间	2025 年 3 月 6 日整理